

证券代码：002156

证券简称：通富微电

通富微电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-002

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	兴业证券：仇文妍；喜世润投资：任若天；上银基金：惠军；东海基金：王亦琛；东北证券：黄磊、蒋佩炎、武芃睿；顶天投资：李胜敏；大笋资管：徐海涛
时间	2024年9月12日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 蒋澍
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司概况</p> <p>通富微电主要从事集成电路封装测试业务，是一家国内领先、世界先进的集成电路封装测试服务提供商，专注于为全球客户提供从设计仿真到封装测试的一站式解决方案。公司的产品、技术、服务覆盖了人工智能、高性能计算、大数据存储、显示驱动、5G 等网络通讯、信息终端、消费终端、物联网、汽车电子、工业控制等多个领域，满足了客户的多样化需求。公司大股东为南通华达微电子集团股份有限公司，实际控制人为石明达先生，股权结构稳定。</p> <p>公司先后在江苏南通崇川、南通苏通科技产业园、安徽合肥、福建厦门、南通市北高新区建厂布局；通过收购AMD 苏州及AMD 槟城各 85%股权，在江苏苏州、马来西亚槟城拥有生产基地。</p> <p>目前，公司在南通拥有 3 个生产基地，同时，在苏州、</p>

槟城、合肥、厦门也积极进行了生产布局，产能方面已形成多点开花的局面，有利于公司就近更好地服务客户，争取更多地方资源。同时，先进封装产能的大幅提升，为公司带来更为明显的规模优势。

财务数据方面，公司 2021 年、2022 年和 2023 年和 2024 年上半年分别实现营收 158.12 亿元、214.29 亿元、222.69 亿元和 110.80 亿元。公司 2021 年、2022 年和 2023 年和 2024 年上半年的归母净利润分别为 9.57 亿元、5.02 亿元、1.69 亿元和 3.23 亿元。

二、行业情况

在信息技术发展的浩瀚星空中，半导体与集成电路不仅是璀璨夺目的星辰，更是驱动整个经济社会高速发展的核心引擎之一。作为战略性、基础性和先导性产业，它们不仅承载着技术创新的重任，更是保障国家安全、促进产业升级的关键力量。2024 年以来，全球半导体行业呈现温和复苏态势。据半导体行业协会（SIA）统计，2024 年上半年全球半导体销售额较 2023 年同期增长；从单季度看，2024 年 Q2 全球半导体销售额同比及环比均实现增长，行业呈现持续改善态势。同时，半导体行业协会（SIA）预计 2025 年全球半导体销售额亦将实现大于 10% 的增长。

具体而言：

半导体行业在经历了 2022-2023 年的去库存后，2024 年库存水位逐渐趋于平稳健康。IC 设计公司和半导体经销商的库存周转在 2023 年 Q1 达到高点后，连续三个季度下降，并在 2023 年 Q4 触底，2024 年 Q1 末平均周转天数较去年同期减少了 69.78 天，表明行业去库存进展顺利。

从下游应用领域看。AI 需求爆发带动逻辑和高端存储需求快速反弹。消费电子回暖复苏，2024 年上半年全球智能手机销量 5.75 亿部，同比增近 7.2%；中国 2024 年 618 购物节智能手机销量同比增长 7.4%；据 SEMI 统计，消费电子复苏带动全球 IC 库存水位同比下降 2.6%。而在

汽车和工业领域，2024 年上半年整体需求较弱，展望下半年，随着车规级芯片和工控芯片市场逐步触底，汽车和工业需求有望重回增长。

在行业景气整体复苏的同时，在 AI 革命催化下先进封装正迎来加速发展。一方面，AI 需求爆发持续拉升对先进封装的需求；另一方面，AI 算力正实现从训练到推理、从云端到端侧的转向，这种趋势亦推动先进封装技术正变得日益多元化。

三、2024 年上半年业绩情况

2024 年上半年，全球半导体行业迎来了明显复苏势头，公司积极进取，产能利用率提升，特别是中高端产品营业收入明显增加。得益于公司战略精准定位和经营策略的有效执行，公司实现营业收入 110.80 亿元，同比增长 11.83%，实现归母净利润 3.23 亿元，经营成效改善显著。其他 2024 年半年度详细情况，可以关注公司对外披露的《2024 年半年度报告》。

四、投资者关注的主要问题

问题 1：简单介绍一下公司的业务情况及应用领域？

回复：公司是集成电路封装测试服务提供商，为全球客户提供设计仿真和封装测试一站式服务。公司的产品、技术、服务全方位涵盖人工智能、高性能计算、大数据存储、显示驱动、5G 等网络通讯、信息终端、消费终端、物联网、汽车电子、工业控制等领域。公司紧紧抓住市场发展机遇，面向未来高附加值产品以及市场热点方向，立足长远，大力开发扇外型、圆片级、倒装焊等封装技术并扩充其产能；此外，积极布局 Chiplet、2D+等顶尖封装技术，形成了差异化竞争优势。

问题 2：2024 年上半年，通富超威槟城收入同比下滑，且槟城工厂盈利能力低于苏州工厂，是什么原因？

回复：通富超威槟城 2024 年上半年收入与去年同比下滑主要是 AMD 游戏机产品下滑所致；同时，槟城工厂在

建设先进封装生产线，投资大、融资成本高，导致其盈利水平低于苏州工厂。

问题 3：今年上半年公司各类业务经营情况如何？

回复：2024 年上半年，在消费市场方面，公司持续紧抓手机及消费市场复苏机遇，传统框架类产品市场稳定，营收实现不断提高。在新兴市场方面，射频产品市场国产替代势如破竹，公司把握先机，系统级（SiP）封装技术的射频模组、通讯 SOC 芯片等产品不断上量，持续扩大市场规模；同时，存储器（Memory）、显示驱动（Display Driver）、FC 产品线也展现出强劲增长势头，保持超 50% 的高速增长，展现了公司新兴产品线强劲的市场竞争力和生产效率。

2024 年上半年，AI 芯片市场规模快速增长。根据 Gartner 预测，2024 年全球 AI 芯片市场规模将增加 33%，达到 713 亿美元，2025 年有望进一步增长 29%，达到 920 亿美元；2024 年服务器 AI 芯片市场规模将达到 210 亿美元，至 2028 年，有望达到 330 亿美元，CAGR 为 12%。公司客户 AMD 的数据中心业务超预期增长，得益于云客户和企业客户对 Instinct GPU 和 EPYC 处理器的强劲需求，其中 MI300 GPU 单季度超预期销售 10 亿美元，AMD 今年数据中心 GPU 收入为 45 亿美元，此前为 40 亿美元。随着 AI 芯片需求的暴涨，先进封装产能成为了 AI 芯片出货的瓶颈之一，台积电、日月光、安靠均表示先进封装产能紧张、相关订单需求旺盛。在先进封装市场方面，公司持续发力服务器和客户端市场大尺寸高算力产品。依托与 AMD 等行业龙头企业多年的合作积累与先发优势，基于高端处理器和 AI 芯片封测需求的不断增长，公司上半年高性能封装业务保持稳步增长。同时，随着 AI+行业创新机会增多，人工智能产业化进入新阶段，公司配合 AMD 等头部客户人工智能发展的机遇期要求，积极扩产槟城工厂，全方位满足客户需求。

机遇往往与挑战共存，上半年工控及功率半导体市场下游需求相对疲弱，全球游戏机市场整体呈现低迷状态。面对上半年市场挑战，公司积极采取应对措施，通过调整优化客户结构等方法来减轻市场变化对公司经营的潜在影响，通过构建更加稳健和多元化的客户基础，增强公司在不断变化的市场环境中的适应能力和竞争力。

问题 4：公司对于先进封装方面有哪些布局？今年上半年有哪些技术升级？

回复：在先进封装布局方面，公司面向高端处理器等产品领域持续投入，进一步加大研发力度，布局更高品质、更高性能、更先进的封装平台，全方位配合海内外客户的发展需求，拓展先进封装产业版图，为新一轮的需求及业务增长夯实基础，带动公司在先进封装产品领域的业绩成长。

2024 年上半年，公司对大尺寸多芯片 Chiplet 封装技术升级，针对大尺寸多芯片 Chiplet 封装特点，新开发了 Corner fill、CPB 等工艺，增强对 chip 的保护，芯片可靠性得到进一步提升。公司启动基于玻璃芯基板和玻璃转接板的 FCBGA 芯片封装技术，开发面向光电通信、消费电子、人工智能等领域对高性能芯片的需求。此项技术有助于推动高互联密度、优良高频电学特性、高可靠性芯片封装技术的发展，目前已完成初步验证。Power 方面，公司上半年完成了 Easy3B 模块的研发，开始进入小批量量产，国内首家采用 Cu 底板灌胶模块，应用于太阳能逆变器，相对于市场传统的 Easy1B、2B 模块，能更有效的降低系统的热阻及功耗。2024 年上半年，公司 16 层芯片堆叠封装产品大批量出货，合格率居业内领先水平；国内首家 WB 分腔屏蔽技术、Plasma dicing 技术进入量产阶段。

问题 5：公司上半年的专利情况怎么样？

回复：截至 2024 年 6 月 30 日，公司在知识产权方面取得了显著成果。累计申请专利达 1,589 件，其中发明专

	<p>利占比近 70%。同时，累计软著登记 93 件。</p> <p>问题 6: 请问京隆科技收购项目目前进展情况如何?</p> <p>回复: 公司已于 2024 年 5 月 13 日在 2023 年度股东大会中审议通过了《关于收购京隆科技(苏州)有限公司 26% 股权的议案》，京隆科技项目正在进行中，公司将按照信息披露要求履行信披义务，相关情况请关注公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的公告。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024 年 9 月 12 日